

表 適格性閾値基準

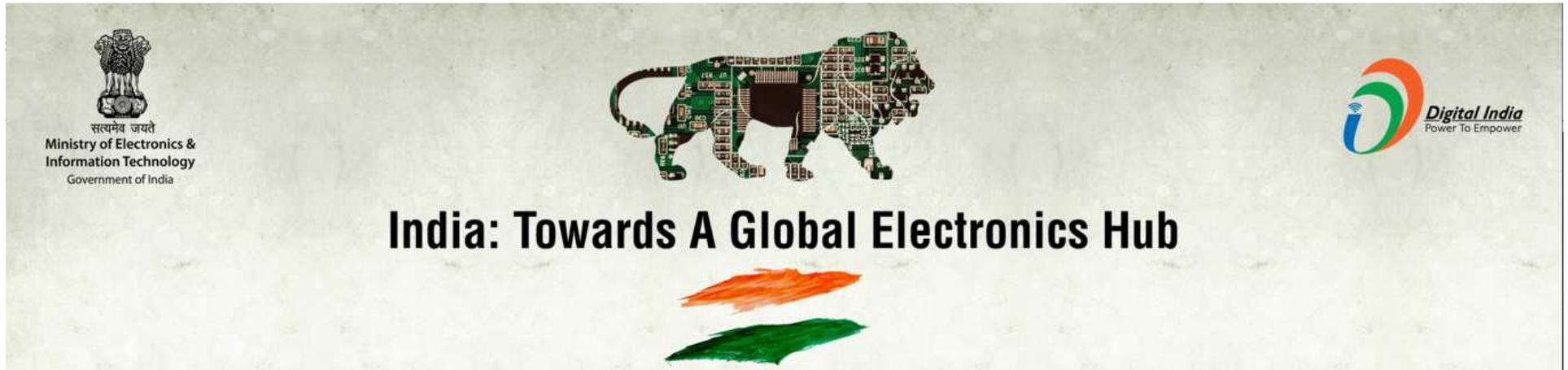
(単位:ルピー)

セグメント	インセンティブ	基準年度対比の追加投資額	基準年度対比の売上増加額
携帯電話 (INR 15,000以上のインボイス 価格)(注1)		4年目以降100億 累積最低額: 1年目:25億 2年目:50億 3年目:75億 4年目:100億	1年目:400億 2年目:800億 3年目:1,500億 4年目:2,000億 5年目:2,500億
携帯電話 (インド国内企業)(注2)	1年目:6% 2年目:6% 3年目:5% 4年目:5% 5年目:4%	4年目以降20億 累積最低額: 1年目:5億 2年目:10億 3年目:15億 4年目:20億	1年目:50億 2年目:10億 3年目:200億 4年目:350億 5年目:500億
特定電子部品		4年目以降10億 累積最低額: 1年目:2.5億 2年目:5億 3年目:7.5億 4年目:10億	1年目:10億 2年目:20億 3年目:30億 4年目:45億 5年目:60億

(注1)適格性については、インボイス価格に関わらず、セグメントに含まれる全ての製品の売上増加額を考慮する。

(注2)2017年FDIポリシー通達で定義されているインド居住者が所有する企業を指す。

(出所)インド電子情報技術省発表資料を基に作成



# 電子産業 投資の手引き





# 新しいインド



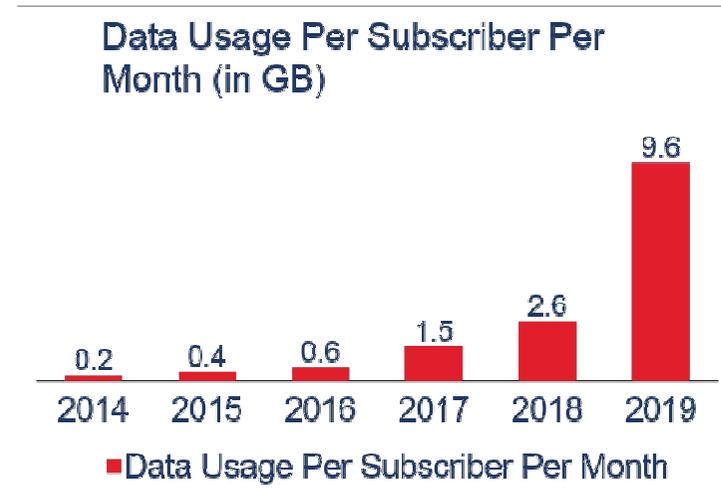
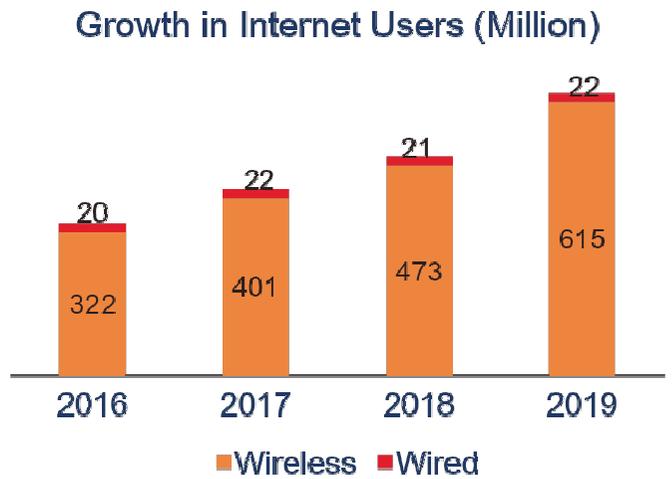
**12億人**  
携帯電話契約者



**6億100万人**  
インターネット  
利用者

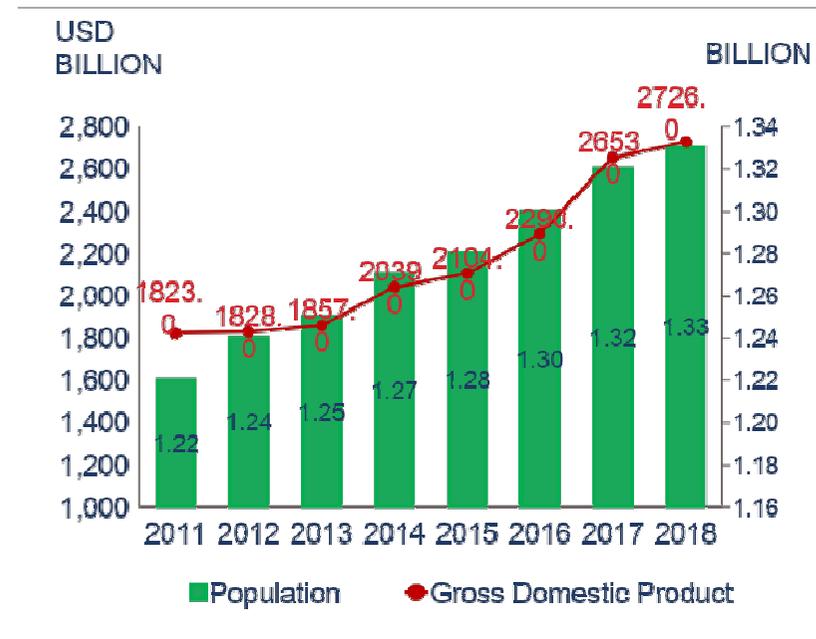
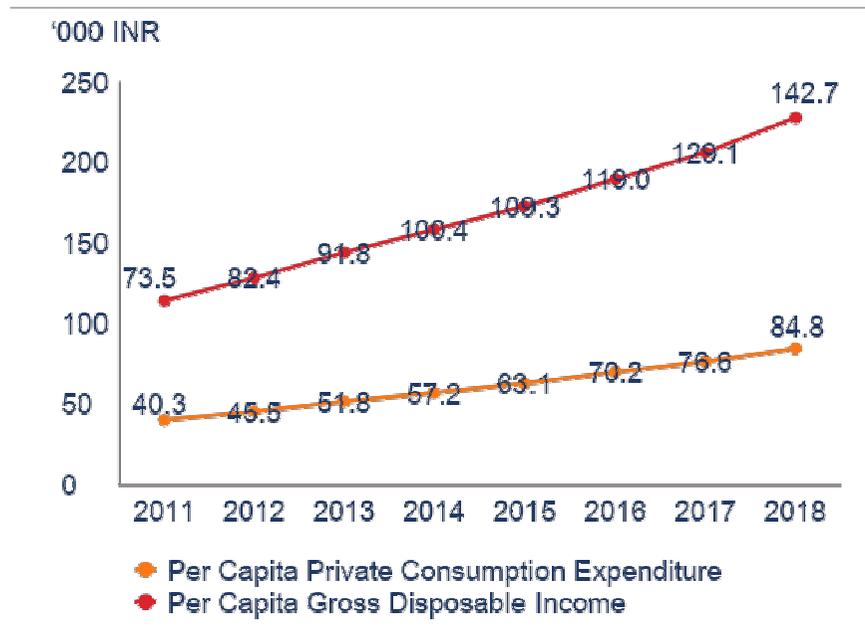


世界で最も急速に成長する  
エコシステム





## 過去7年間、一人当たり可処分所得と消費は倍増した

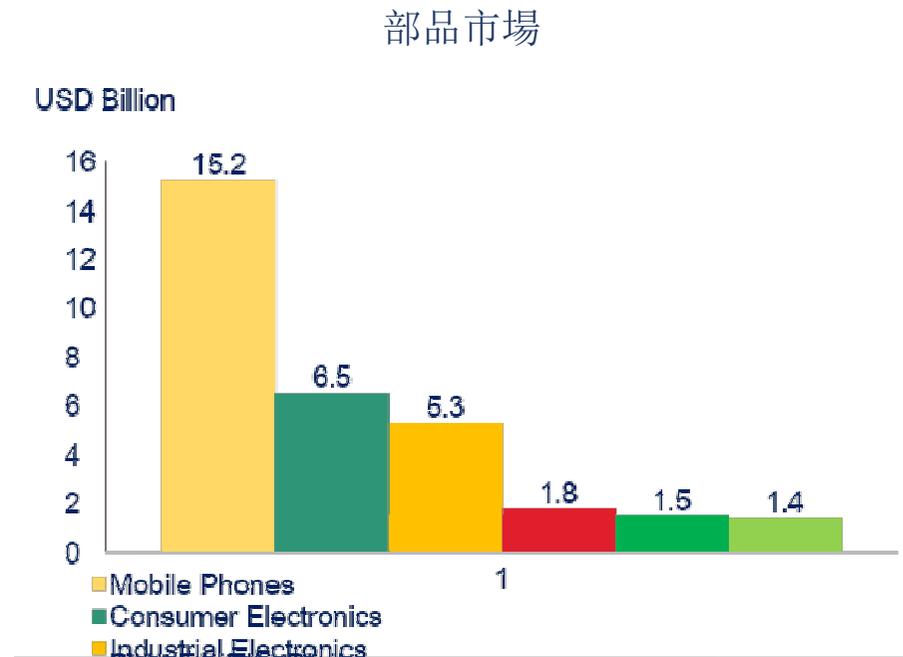
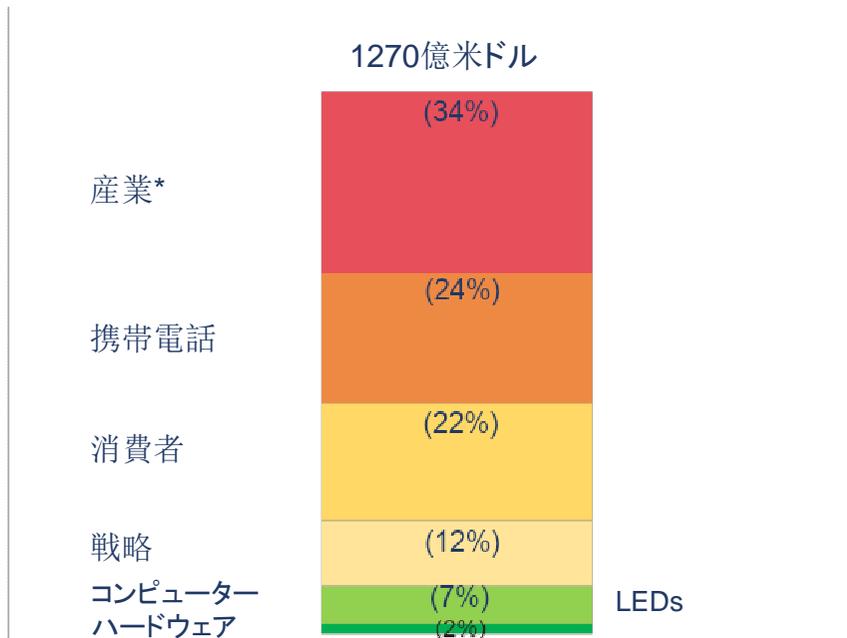


出典: インド準備銀行 (RBI) 世界銀行





## 1270億米ドル規模の市場機会



出典: ELCINA – Taskforce Report (2019)

\*産業用電子製品は、自動車向け、医療向けを含む

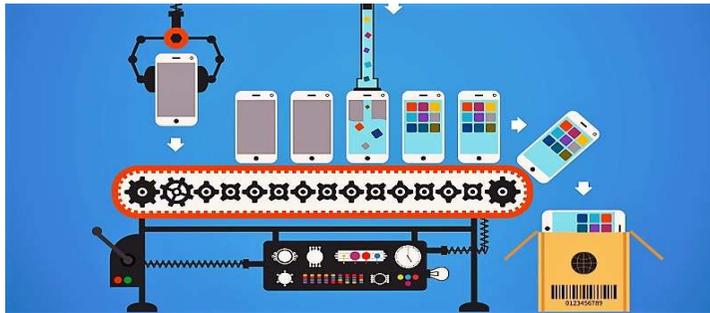


Ministry of Electronics and Information Technology  
Government of India

सत्यमेव जयते



## 携帯電話製造における成長が、これからの方向性を示唆している



インドは世界第二位の携帯電話機製造国として台頭している  
260以上の生産拠点で、携帯電話機と部分組立品／部品を製造している。

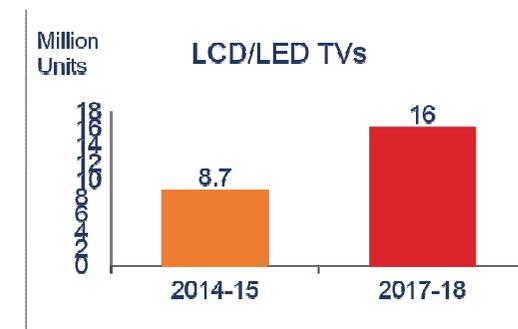
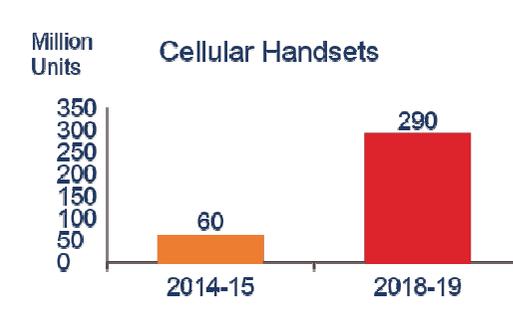
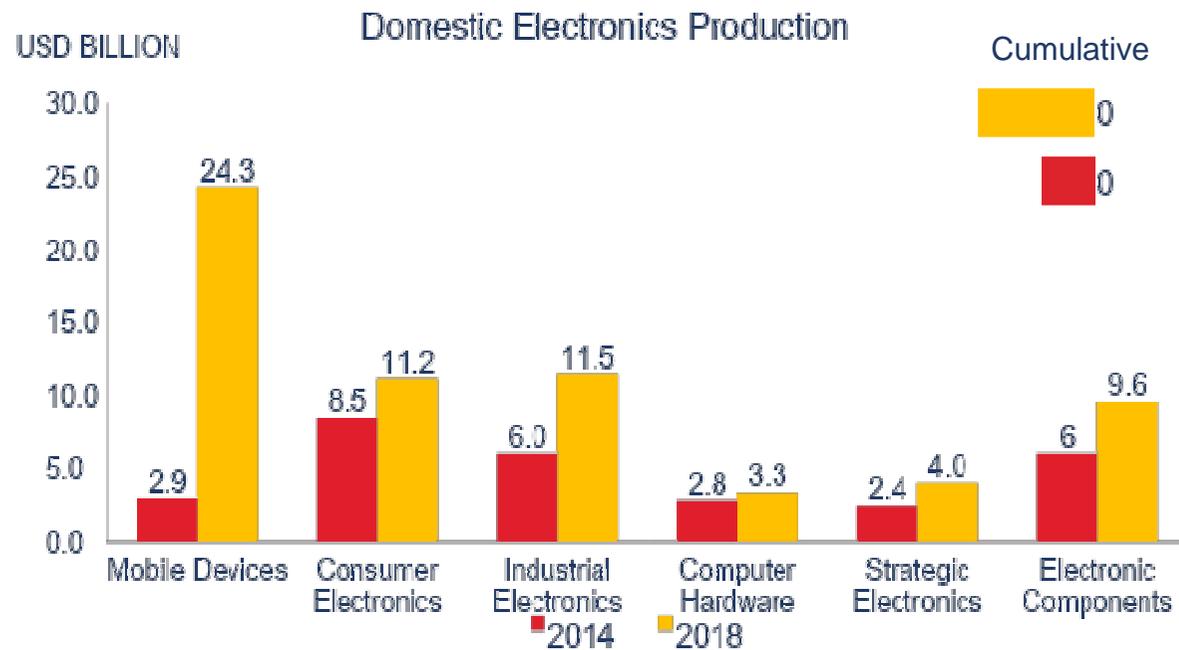
	2014	2019
 携帯電話機製造拠点	2	264
 生産された携帯電話機台数 *	6000万	3億3000万
 携帯電話機の生産額*	30億米ドル	300億米ドル

\*会計年度に関する数値





## 過去4年間に於いて電子製品生産は倍増以上となっている



出典: 電子情報技術省 (MeitY)





## 電子システム設計製造(ESDM)をめぐる背景

### 主要なクラスター/ハブ

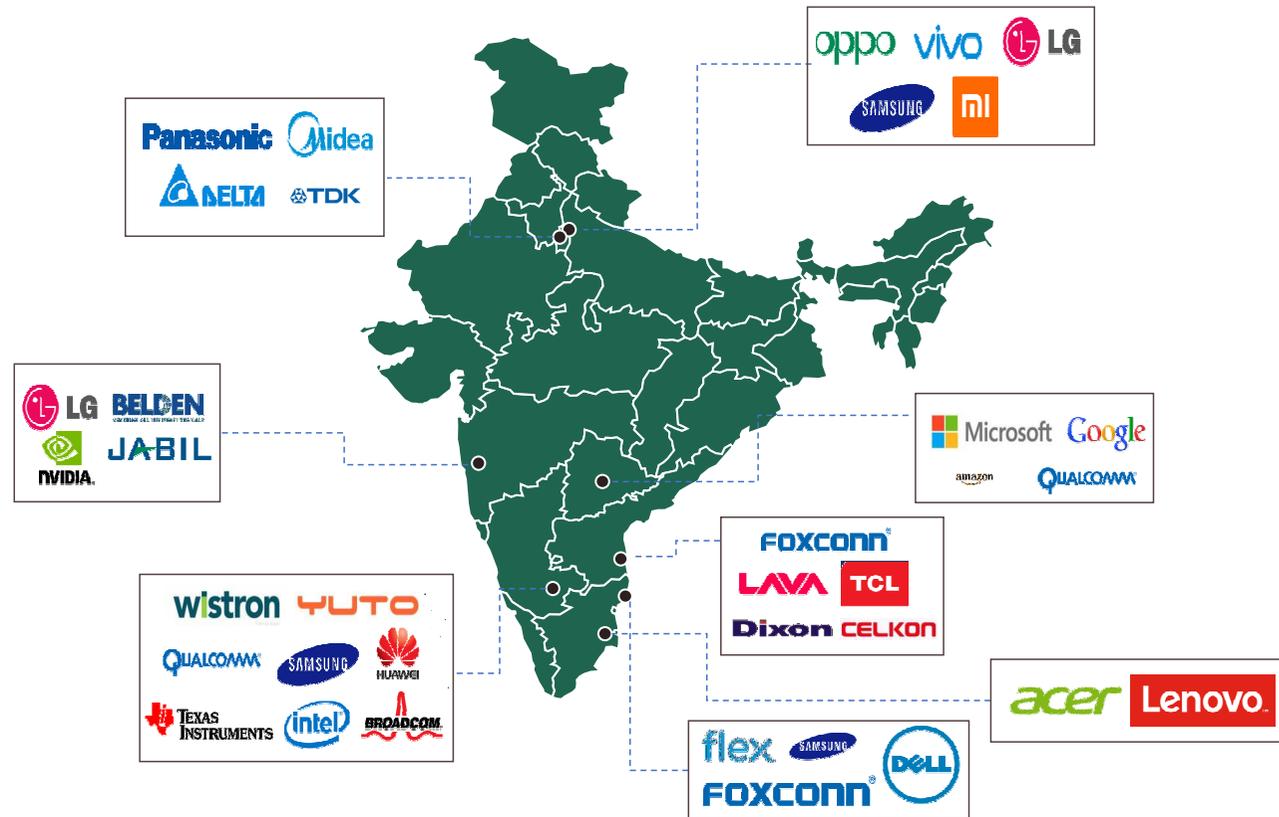
デリー首都圏 -ノイダ、グレーター、ノイダ、グルガオン  
タミルナドゥ州 - チェンナイ、スリペルンドゥル

アンドラプラデッシュ州 -ティルパティ、スリシティ

マハラシュトラ州 -プネ

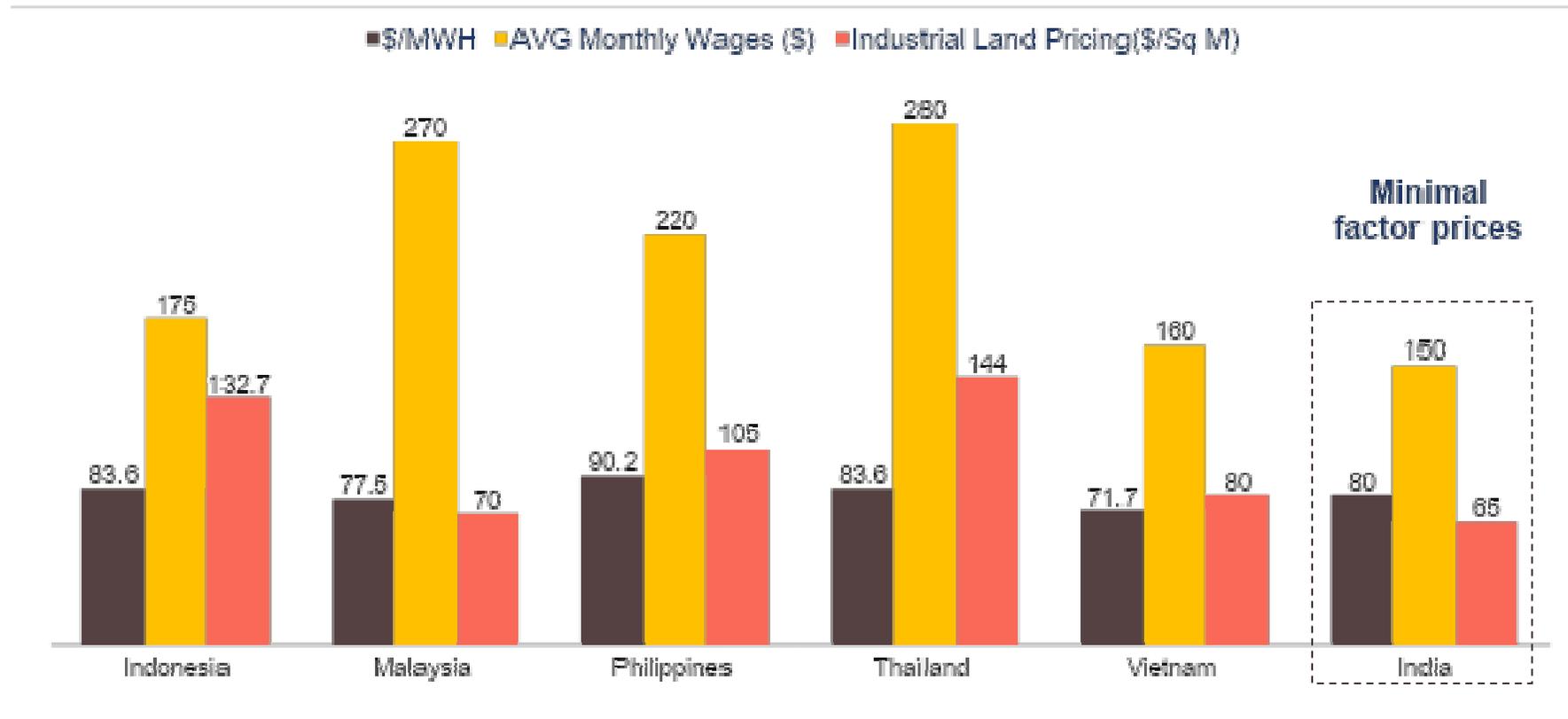
カルナタカ州 - バンガロール、マイソール

テランガナ州 -ハイデラバード





## 有利な製造費





## 介入と優遇策

### 関税に関する介入

- 関税構造の合理化
- 物品サービス税(GST)の実行
- 段階的製造プログラム (PMP)
- 資本財に課される基本関税(BCD)の免除

### 課税以外の介入

- 中古機械輸入に関する手続きの簡略化
- 強制登録制度 (CRO)
- 投資促進 - 電子情報技術省 (MeitY) と インベスト・インドア (Invest India)

## Incentive Schemes

### 特別優遇策パッケージ・スキーム改訂版

- 資本支出補助金: 20% (SEZ); 25% (SEZ以外)
- 受理された申請の総数: 410
- 価値総額150億米ドル以上の投資提案

### 電子製品製造クラスター(EMC)

- 15州で23件のプロジェクト - 20件の新規EMCと3か所の共通施設センター
- 完全に開発された3,565エーカーの土地が取得可能





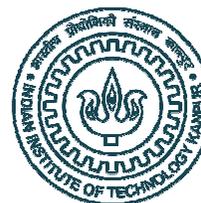
## 有利な優遇策

### 電子製品開発ファンド(EDF)

- イノベーション、知的財産創造、研究開発、製品開発の推進を目的とする、ファンドのためのファンド
- EDFを通じて9500万米ドルが確保されている
- 目標とする投資資金総額:7億8500万米ドル

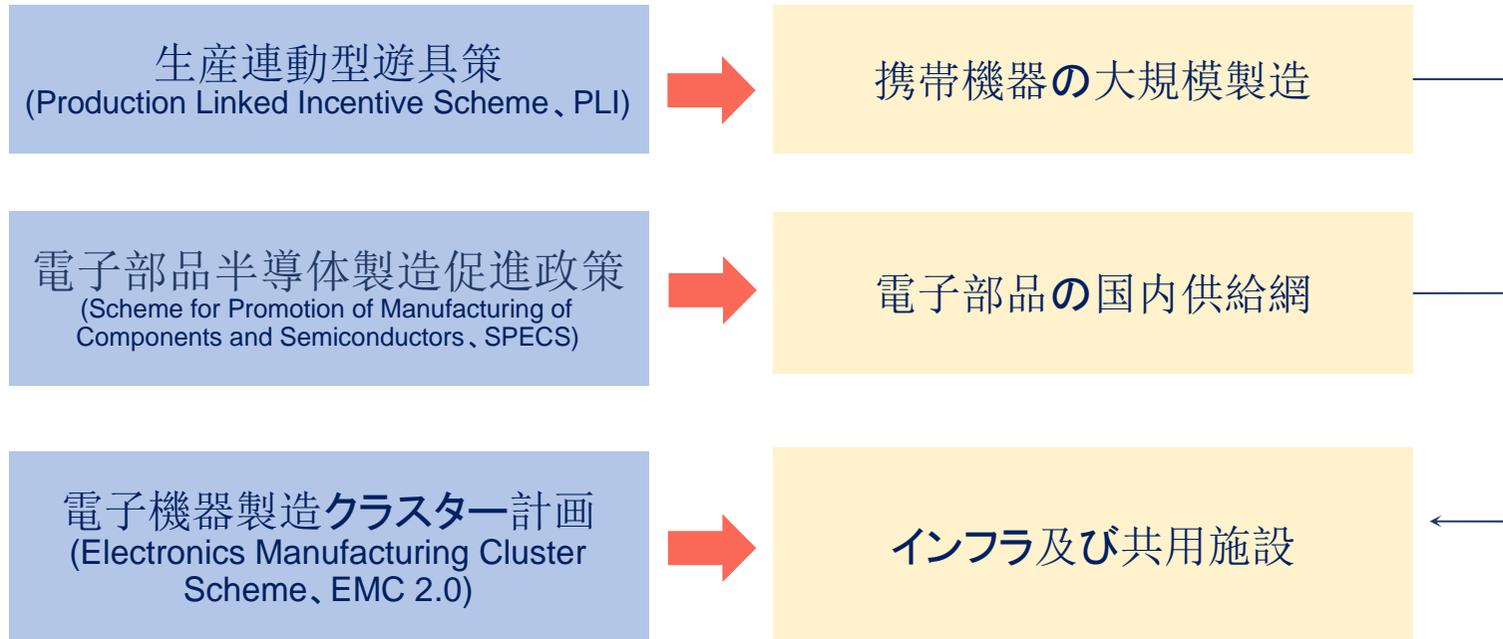
### ナショナル・センター・オブ・エクセレンス (National Centers of Excellence)

- 広域向けの柔軟性ある電子製品
- 国内治安に関する技術
- アクティブマトリクス式有機EL (LAMOLED)
- 医療用・生物物理学向け電子製品 & Bio-Physics





## 電子機器製造に向けた政策提案





## 生産連動型優遇策(Production Linked Incentive Scheme、PLI)



### 優遇策のメカニズム

4% - 6%  
5年間の生産連動型優遇策

### 対象製品

携帯電話と電子部品

### 支出額

~60億USDドル

- 需給要件として企業ごとの最低投資額及び最低生産量が設定されている
- 1社あたりの年間び総受給額に上限を設定





## 電子部品と半導体製造促進政策

(Scheme for Promotion of Electronic Component Manufacturing and Semiconductors, SPECS)



ELECTRONICS INDIA  
Billion Needs Million Chips

優遇策 (~5億USD)	設備投資額の25%に当たる額を償還する財政優遇策
期間	申請書提出に3年間、投資は5年間
対象部門	能動部品及び受動部品、半導体など (完成品は除外)
対象となる設備	工場、機械、機材、R&D (土地と建物は除外)
最低投資額	70万USDから1億4000万USDに及ぶ



Ministry of Electronics and Information Technology  
Government of India

सत्यमेव जयते



## 修正版・電子機器製造クラスター計画 (Electronics Manufacturing Cluster Scheme、EMC 2.0)



### 主な特徴:

- 大規模電子機器製造クラスター (最小土地面積 200エーカー)
- アンカーユニット区画 (要件: 事業用地の20%、投資額4000万USD以上)
- プラグ・アンド・プレイインフラ
- 共用施設センター
- 事業実行機関 – 政府機関または産業開発公社

#### EMC事業

- 事業コストの50%
- 上限: 100エーカー毎に1000万USD

#### 共用施設センター(CFC)

- 事業コストの75%





## 税制改革

### 改革前

法人税率
<b>25%</b> - 歳入 < 6000万USDル <b>30%</b> - 歳入 > 6000万USDル
最低代替税
<b>18.5%</b>

### 改革後

法人税率
<b>15%</b> - 新規製造拠点* <b>22%</b> - 国内企業*
最低代替税
<b>15%</b>

### 関税

事前認可
<ul style="list-style-type: none"><li>輸出製品の材料に係る輸入関税の免除</li><li>輸出品について最小付加価値15%が必要に</li></ul>

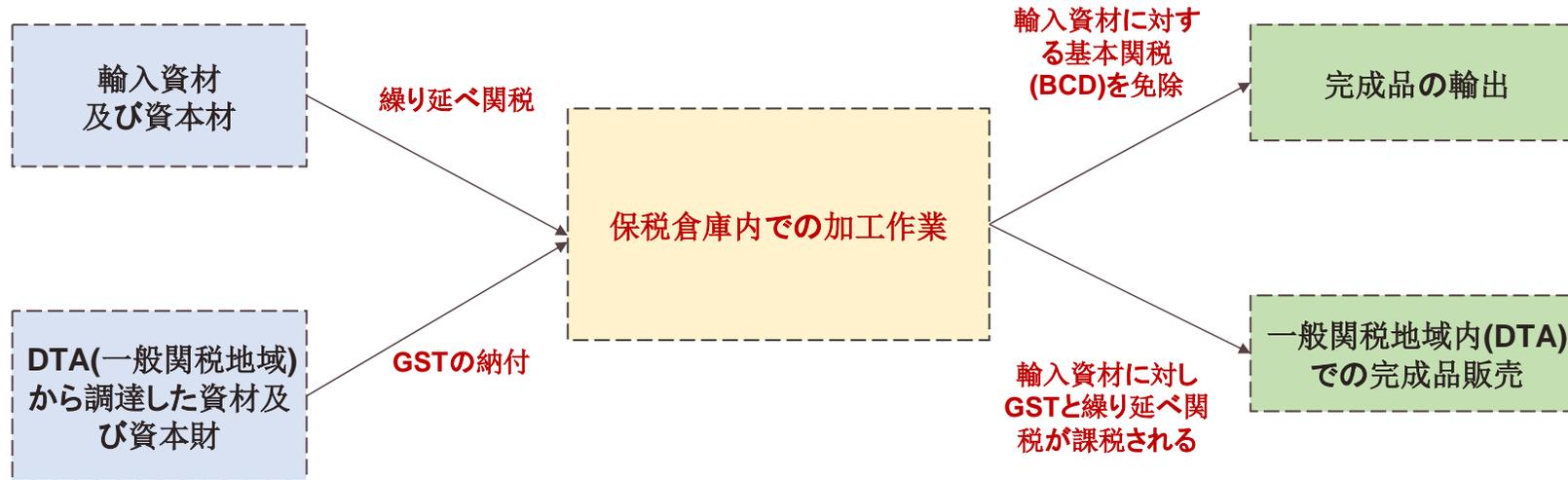
207億USDル相当の税収を放棄





## 保税倉庫内での製造活動

### 関税法 第65項





# インドのスタートアップ環境

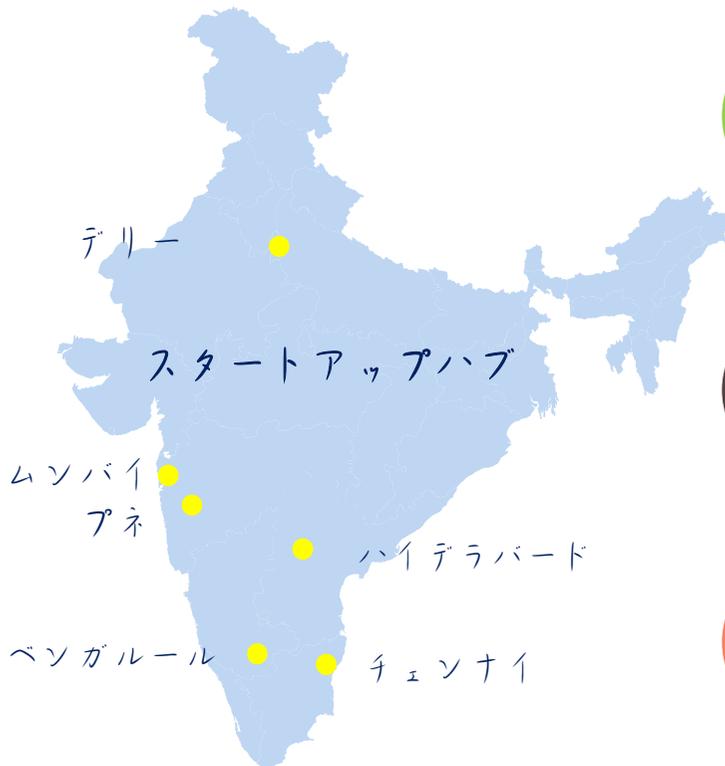


**50,000+**  
インドのスタートアップの数

**\$95 B**  
企業価値総額

**330+**  
インキュベーター/アクセラレータ数\*

**290億USドル**  
2016年1月以降の総投資額



28歳  
創業者  
平均年齢



30社  
ユニコーン  
企業数  
2017年から  
23社増加



40%  
インキュベーターの年間増加率



55%  
都市部を拠点とするスタートアップ数



9%  
女性起業家の割合



700社以上  
ユニコーン企業から誕生したスタートアップ数

[www.investindia.gov.in](http://www.investindia.gov.in)



Ministry of Electronics and Information Technology  
Government of India



# 最も好まれるR&D拠点進出先 – 国内の多国籍企業のR&Dセンター数は1140カ所



バンガロールのサムソンR&Dセンターは、同社の国外R&Dセンターとしては世界最大規模

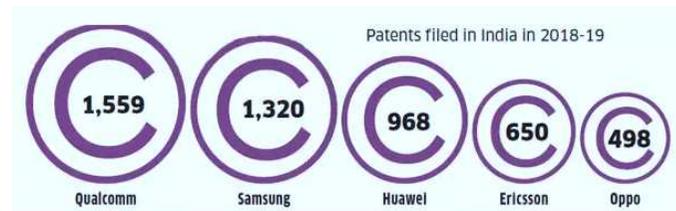
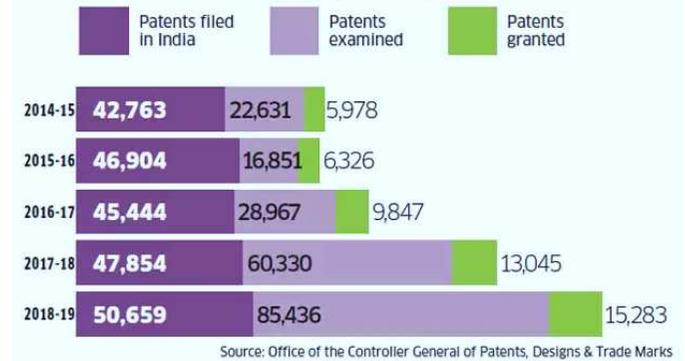


バンガロールにあるインテル社のインディア・デザイン・センターは同社が米国外に持つR&Dセンターの中では最大級



Apple、Amazon、Google、Uberは同社2番目の規模となる開発センターの開設を米国外、ハイデラバードで計画している

## Examined Patents Have Quadrupled in 4 Years



インド国内の多国籍企業のR&D拠点数1140か所 | R&D専門家数は90万人



Ministry of Electronics and Information Technology  
Government of India

सत्यमेव जयते



インドで皆様にお会いするのを楽しみにしております



Ministry of Electronics and Information Technology  
Government of India

सत्यमेव जयते

## 電子情報技術省

# 大規模電機製造のために生産連動インセンティブ計画

## 1. 背景

- 1.1. 電気製品は経済の各分野に浸透し、電機業界は経済的と戦略的に重大な役割を果たしています。ここ4年間、インドの電機製造のCAGR（平均成長率）は25%で、急成長を見せています。でも、これを、大資本投資や技術の劇的な変化などのよう特定の制約によって制限されている潜在的な成長と比べたらまだ低い程度です。政府は大規模投資を製造分野に誘致するため、製造を助長させるような環境整備とほかの国と同じくらのインセンティブを与えることに力を注いでいます。
- 1.2. インドにのグローバル製造のシェアは2012年に1.3%だったが2018年に3.0%まで増えています。電機の国内生産も徐々に成長し、2014-15年に1兆9036億6千万ルピー（290億ドル）から2018-19年に4兆5800億6千万おルピー（700億ドル）に拡大しました。2025年まで国内需要あは27兆ルピー（4000億ドル）まで増加する見通しはあるが、インドは電機の輸入による増加しつつある外資出資に対応しできなくなっています。
- 1.3. 電機製造分野は他の計のせいで限定的な緩和しか持たないため、この製造の不自由を償うために他の製造経済と相当なメカニズムは必要です。

- 1.4. **機会の出現と伴う平等な条件**：電機製造分野は競争している国と比べたら平等の条件が整っていないです。業界の統計によると（ICEAとELCINA）、インフラの未整備、国内サブと物流、金融の高コスト、電力品質の不十分な可用率、デザイン能力のと研究開発への集中の乏しさ、スキル開発の不備などによって発生した障害率は8.5%－11%とされています。
  
- 1.5. **電機の国家政策（NPE2019）**：NPE 2019のビジョンは、チップセットをはじめ、中核部品の発展とグローバル競争うよに対応できる環境作りの促進と能力向上を果たして、インドを電子システム設計及び電子機器製造クラスターのグローバル拠点にすることです。
  
2. **目的**：大規模電機製造のために生産連動インセンティブ計画は、国内生産の向上と、電気部品と半導体包装を含め、電機バリューチェーンに投資を誘致するため報奨金を提案しています。
  
3. **インセンティブの趣旨**：文章7番に定義されている、**5年間**たえにわたって（基準年から）特別分野の有資格の会社によって国内で製造されたものの増分売上に**4%－6%**のインセンティブを与えます。
  
4. **対象分野**：この計画は特殊分野いわゆる携帯電話と特定部品のみに適します。（副文Bに詳細）
  
5. **有資格**：この計画にの対象になるのは特定分野の製造に取り組んでいる会社のみです。これに2017のFDI方針書に定義されている委託製造者も含まれます。
  
- 5.1. 各申請は一つの特定分野だけに限られています。

**W-28/1/2019-IPHW-MeitY**  
**電子情報技術省**  
**(IPHW区)**

- 5.2. 有資格は製造品の増分投資と増分売上のしきい値によります（貿易品と違って）。インセンティブをもらうには申込者はしきい値の条件に適格でなければなりません。有資格のしきい値条件は副文Aに明確になっています。
- 5.3. 生産連携インセンティブ計画に有資格であることは他の計画の有資格性には関係しをもっていません。
6. 計画の期間：文章7番に定義されているように、5年間にわたって（基準年から）、この計画によって支援されます。
- 6.1. 最初にこの計画に申請できる期間は4ヶ月だが、延長される可能性もあります。
- 6.2. 計画の申請期間は業界の反応によって再び開始されるかもしれないです。
- 6.3. 最初の計画の期間終了後に受けた申請は計画の残りの期間だけのインセンティブに適格します。
7. 基準年：2019-20年度は製造品の増分投資と増分売上进行を計算するための基準年されます。
8. インセンティブ経費
- 8.1. 総インセンティブ：年次インセンティブ経費と累計インセンティブ経費の予測は次のようです：

年次	インセンティブ総額
	インドルピー
1年目	533.4億
2年目	806.4億

**W-28/1/2019-IPHW-MeitY**  
**電子情報技術省**  
**(IPHW区)**

3年目	842.5億
4年目	1148.8億
5年目	764億
合計	4095.1億

8.2.会社あたりのインセンティブ：計画責任委員会によって定められた限度に従い、基準年から、会社あたりインセンティブは製造品（貿易品と違って）の増分売上によります。

## 9. 計量の根拠

9.1.適している部/省/庁と法定監査人によって定められた仔細をもとにして増分投資と売上の評価は行われます。

9.2.機能基準は電子情報技術省によって、関係省庁の顧問を済ました上に発行されます。

## 10. 承認と支払いプロセス

10.1. この計画に申請できる会社はインドに登録されている各会社です。

10.2. 期日の前に最初段階のあらゆる面で完成された申請を申し込みます。申請の最初の細見の後に受領書が発行されます。受領書は決してPLI計画に承認を意味していません。

10.3. 有資格の申請は進行中に評価され、承認の考慮に至ります。

10.4. インセンティブは必要な閾値を満たし、支払金請求が適切である申込者に与えられます。

10.5. 計画のインセンティブは2020年08月01日から利用できます。

## 11. 節点機関

11.1. 計画は、節点機関によって実施されます。

**W-28/1/2019-IPHW-MeitY**  
**電子情報技術省**  
**(IPHW区)**

11.2. このような節点機関はプロジェクト管理機関（PMA）として勤め、度々電子情報技術省に委託された業務と秘書や管理や実施のサポートをするのは義務付けられています。PMAの組成と機能と責任についての仔細は計画基準に明確します。

11.3. PLIの計画の実施に関する行為を施行するため、PMAは以下に対するとりわけ責任があります：

11.4. 計画に属する支援のため申請の評価と有資格の確認

11.5. 計画に属するインセンティブの支払い適格の請求の細見

11.6. 計画に属する会社のため、製造された商品の増分投資と売上を含む計画の進歩と業績に関するデータの編集

## 12. 計画責任委員会（EC）

12.1. CEO NITI アヨグと経済担当国務長官、支出長官、電子情報技術省長官、収益長官、DPIIT長官とDGFTを含めた計画責任委員会は形成されます。

12.2. ECは、計画に属するプロジェクト管理機関に有資格と認められた申請を思慮します。

12.3. ECは、出納のために手続きにしたがって、プロジェクト管理機関によって細見と推薦した請求を思慮します。

12.4. ECは、計画いに属している会社の投資、雇用の創出、生産と付加価値に基づいて、定期的な見直しをします。

12.5. ECは、企画期間に適切とされた時、インセンティブ率、対象分野と資格条件を改正かもしれません。

12.6. ECは、計画の基準を改正することが許可されています。

12.7. 組成、機能と責任の仔細は計画の基準に明確しにされています

**副文A**

**W-28/1/2019-IPHW-MeitY**  
**電子情報技術省**  
**(IPHW区)**

定格性閾値条件

分野	提案されたインセンティブ率	基準年から増分投資	基準年から製造品の増分売上
携帯電話 (1万5千インドルピー以上の請求書) *		4年間に100億インドルピー 累積最小限 1年目：25億 2年目：50億 3年目：75億 4年目：100億	1年目：400億インドルピー 2年目：800億インドルピー 3年目：1500億インドルピー 4年目：2000億インドルピー 5年目：2500億インドルピー
携帯電話 (国内会社)**		4年間に20億インドルピー 累積最小限 1年目：5億 2年目：10億 3年目：15億 4年目：20億	1年目：50億インドルピー 2年目：100億インドルピー 3年目：200億インドルピー 4年目：350億インドルピー 5年目：500億インドルピー
指定された電子部品 (副文 B に詳述 )		4年間に10億インドルピー 累積最小限 1年目：2.5億 2年目：5億 3年目：7.5億 4年目：10億	1年目：10億インドルピー 2年目：20億インドルピー 3年目：30億インドルピー 4年目：45億インドルピー 5年目：60億インドルピー

\*資格のために生産商品の伸し上げ売上の仕切り値段にかかわらずに思慮します。

\*\*国内会社とは、外国直接投資の2017年の方針により、インド在住の市民によって所有された会社として定義されています。その首都の50%以上が在住インドの市民やインドの会社によって有益に所有されるならば、会社は在住インドの市民によって「所有される」と、思われます。そして、それは在住インドの市民によって最後に所有されて、支持されます。

PLI 計画による有資格の電子部品の表

番号	Description of Goods
1.	商品の説明
2.	SMT部品
3.	トランジスタ、ダイオード、サイリスターなどのディスクリート
4.	電気用のためにレジスターを含む受動素子、コンデンサーなど
5.	プリント基板 (PCB)、PCB 積層、プレプレグ、感光性高分子膜、プリント基板印刷インク
6.	センサ、トランスデューサー、アクチュエータ、電気用のクリスタル
7.	包装のシステム
8.	微小な電気機械システムとナノ電気機械システムのようなマイクロ/ナノ電子部品

## 機部品と半導体の製造の促進計画 (SPECS)

### 1. バックグラウンド

インド政府の「Make in India」プログラムと「デジタルインド」プログラムの重要な柱の1つであるため、政府は電子機器のハードウェア製造に高い優先度を付けています。インドのエレクトロニクス製造業は現在、エレクトロニクス製造のさまざまなセグメントやバリューチェーンのさまざまな段階で競合する経済と比較して、8~10%の障害に直面しています。

1.2 国内の電子機器製造はここ数年で相当に増加し、セミノックダウン (SKD) レベルから完全ノックダウン (CKD) レベルの製造に着実に移行しています。しかし、国内の付加価値は依然として低く、10~30%の範囲に過ぎません。これは、国内に電子部品製造エコシステムの不足、半導体製造エコシステムの不足、ディスプレイ製造エコシステムの不足のためです。国内の電子機器製造の主な成長は、主に国内需要に応えるために、輸入された電子部品/サブアセンブリ/部品からの完成品の組立てにより発生しています。

1.3 国内付加価値の高い電子製品の製造にはサプライチェーンの開発が不可欠です。2019年2月25日に通知されたエレクトロニクスに関する国家政策2019 (NPE 2019) のビジョンは、チップセットを含むコアコンポーネントを開発する国の能力を奨励および推進することにより、インドをエレクトロニクスシステム設計および製造 (ESDM) のグローバル

ハブとして位置づけることで、そして業界がグローバルに競争できる環境を作り出すことです。

1.4 電機と半導体の製造は資本集約的であり、急変している技術に対応しなければなりません。部品は電機にの中心あでもあり、部品表の総額のかなりの部分を占めています。健全な電子機器製造環境は、長期間の持続可能な成長のためと収支を黒字にするため欠かせないものです。

1.5 製造分野に投資を誘致するのに重要な支障をきたしているのは、WTOの情報技術協定のもとで、電気部品と半導体のほとんどが関税制度（BCD）に「無税」になることをはじめ、グローバル規模に合わせるため高い資本コストと、競争性のある電気と水の信頼性や品質や利用可能性などの不足と、サプライチェーンの不足と物流の高コストと、技術不足です。

1.6 改善された特別インセンティブパッケージ計画は金銭的インセンティブを与えて、支障と先行投資コストを補正するあげく、電機製造業界に投資を誘致します。この計画の新プロジェクトと拡張プロジェクトの申請期間は2018年12月31日まででした。この計画のもとに、電機製造施設の建設助成金が与えられます（SEZ区の中の建設に20%とSEZ区の外は25%）M-SIPSはインドで電機製造の促進に重大な役割をはたしています。

## 2. (SPECS)電機部品と半導体の製造の促進計画 (SPECS)

2.1 電機部品と半導体の製造の促進の計画 (SPECS) のもとに電気機器のサプライチェーンを含むリストに定めたように、製造のために資本投資の25%がインセンティブが与えられると提案されました。

## 3. 目的

3.1 この計画で、部品と半導体の国内製造における支障を補正したあげく、国内の製造環境の強化を果たします。

## 4. 適任性

4.1 SPECSは、新しいユニットへの投資だけでなく、既存のユニットの容量の拡張/近代化と多様化にも適用できます。

## 5. 限界値

5.1 投資するため最低限のしきい値は付属されています

5.2 新ユニットと既存のユニットの容積の拡張または、モダン化、多様化のしきい値は同じである。

5.3 インセンティブが与えられたしきい値/部品リストにもし、変更があった場合定期的な見直しが行われます。

## 6. 計画の期間

6.1 通知の期日からSPECSの申請期間は3年間有効です。申し込まれた申請は継続的に評価され、実施は計画のもとの承認によります。

## 7. 計画下のインセンティブ

7.1 付属されたリストにある部品に投資しているユニットには資本投資の25%があたえられます。インセンティブが弁償金として与えられます。

7.2 資本支出は工場、機会、設備、関連する施設、技術と研究開支の合計になります。このような適格である資本支出についての仔細は基準に述べられます。この度、国内か海外に調達したにもかかわらず、改装された工場、機械、設備（関連する施設とR&Dを含め）の総額が有資格のある工場、機械、設備（関連する施設とR&Dを含め）の総額の20%を超えなければ、インセンティブの計算が検討されます。

7.3 州政府や州政府の機関に与えられたインセンティブは計画のインセンティブ以上でなければいけません。

7.4 申請者はインド政府のほかの計画に属することもできます。しかし、M-SIPSに請求済みのあるインセンティブの投資はSPECSの有資格の投資ですとして認められません。

## 8. 許可と支出額の手続き

8.1 インドに登録している会社/機関は計画に申請ができます

8.2 全ての申請は新投資と独立志願として扱われます。申請はシングルフェーズプロジェクトのみが承認され、各工程の申請は検討されません。申込者には複数なところで申請できます。

8.3 あらゆる点で完成された、締め切り前に提出した最初の申請は継続的に評し、承認のために検討されます。

8.4 計画のインセンティブは申請の承認の日付から有効です。承認は申請の最初の細見をしてから発細されます。申請の承認はSPECS による承認というわけではありません。

8.5 インセンティブは、申請の承認日から5年以内に行われた投資に利用できます。

8.6 有資格の設備投資に対するインセンティブの支払いは設備投資の閾値価格と商業生産の開始をを上回っているかどうかを検討上で、申請の承認後にされます。インセンティブの次の請求は六ヶ月ごとに出されます。

。

8.7 SPECS に インセンティブもらっているユニットは商業生産開始の日付から短くとも3年間、または最後のインセンティブの領収日付から1年間商業生産を続かなければなりません。

## 9. 管理の仕掛け

9.1 このスキームは、ノード機関によって実施されます。ノード機関はアプリケーションの評価を行います。

9.2 このような節点機関はプロジェクト管理機関（PMA）として勤め、度々電子情報技術省に委託された業務と秘書や管理や実施のサポートをするのは義務付けられています。PMAの作動と責任は電子情報技術省に発行された計画基盤に詳述しています。

9.3 SPECS の実施に関する作動を施行するために、PMAは以下のとりわけをする

9.3.1. 計画による支援のために申請をうけとり、承認を発行し、値踏みをして、申込者の資格を確認します。

9.3.2 出費の請求を受け、インセンティブを承認された申請に出費します。

9.3.3 スキームの進捗状況とパフォーマンスに関する定期的なレポートをMeitYに提出します。

9.4 PMAは電子情報技術省を占める計画責任委員会（EC）の前に値踏みされて、有資格と承認した申請を置きます。ECは電子情報技術省の長官以上の役員が代表します。ECは適切な部や省や機関の代表を占めます。ECの詳細な規則、作動と責任は計画の基盤に詳細されています。

9.5 ECは申請の認可/不採用/変更のためにPMAを推薦します。ECの推薦によって、コピーが電子情報技術省にあって、PMAは申込者に承諾書を発行されます

9.6 電子情報技術省は計画に基づく認可をえた事業にインセンティブを出すために予算規定を作るべきです。インセンティブは金融規則と認可条件によってPMAに出費されます。PMAはプロジェクトの原則ではなく定期的に電子情報技術省に予算要件を提出します。

9.7 スキームの進捗状況は、Meity書記長の議長の下でMeityによって構成される管理審議会（GC）によりレビューされます。GCは政府と業界の専門家で構成されます。GCは、スキームとそのプロジェクトの進捗状況を定期的にレビューします。GCは、スキームの実施を成功させるために、スキームガイドラインの改訂を随時実施することが認められています。GCの詳細な構成、機能、および責任については、スキームガイドラインで詳しく説明します。

9.8 スキームの下でインセンティブに対して資格がある商品のリストは、適用されるしきい値とともに、管理審議会によって随時見直され、修正されるものとします。

9.9 SPECSスキームを効果的に機能させるために、評価および支払いガイドラインがMeityによって作成され、個別に発行されるものとします。

9.10 スキームの中間評価は、指定された目的の観点から、業界と経済によって得られる利益を評価するために行われるものとします。

SPECSの下でインセンティブに対して資格がある商品のリスト

**A. 最小投資しきい値の制限が5000万ルピーの商品のリスト**

S.No	商品の説明
1.	LEDチップを含むSMTコンポーネント
2.	スマートカード用のチップモジュール、RFIDアンテナおよびラベル、CoB /システム・イン・パッケージ
3.	電子アプリケーション用の抵抗器、コンデンサ、フェライトなどの受動部品
4.	電子アプリケーション用のトランス、インダクター、コイル、リレー、スイッチ、マイクロモーター、ステッピングモーター、BLDCモーター、コネクタ、ヒートシンク、アンテナ、スピーカー、マイクなどの電気機械部品
5.	電子部品用のマグネトロン、ウェーブガイド、サーキュレーター、カプラー、アイソレーター、フィルター、マグネット、RFコンポーネント
6.	プリント基板 (PCB) 、PCBラミネート、プリペグ、フォトポリマーフィルム、PCB印刷インキ; プリントフレキシブルエレクトロニクス
7.	電子アプリケーション用のセンサー、トランスデューサー、アクチュエーター、クリスタル
8.	カメラモジュール、バイブレーターモーター/リンガー
9.	USB /データケーブル、HDMIケーブル
10.	SPECSの下のすべての商品の資本財

**B. 最小投資しきい値の制限が1.5億ルピーの商品のリスト**

**W-18/30/2019-IPHW-Meity****電子情報技術省****(IPHW区)**

<b>S. No.</b>	<b>商品の説明</b>
1.	活性成分: a. トランジスタ、ダイオードなどを含む個別の半導体デバイス b. FET、MOSFET、サイリスタなどを含むパワー半導体
2.	シリカと光ファイバーのプリフォーム
3.	ディスプレイアセンブリおよびタッチパネル/カバーガラスアセンブリ

**C. 最小投資しきい値の制限が2.5億ルピーの商品のリスト**

<b>S. No.</b>	<b>商品の説明</b>
1.	マイクロ電気機械システム (MEMS) やナノ電気機械システム (NEMS) などのようなマイクロ/ナノ電子コンポーネント
2.	アセンブリ、テスト、マーキング、パッケージング (ATMP) ユニット

**D. 最小投資しきい値の制限が7.5億ルピーの商品のリスト**

<b>S. No.</b>	<b>商品の説明</b>
1.	電子アプリケーション用の機械 (プラスチックおよび金属部品)

**E. 最小投資しきい値の制限が25億ルピーの商品のリスト**

<b>S. No.</b>	<b>商品の説明</b>
1.	GaN、SiC、GaAsなどの化合物半導体およびシリコン・フォトニクス・デバイス/集積回路、オプトエレクトロニクス・コンポーネント

W-18/30/2019-IPHW-Meity

電子情報技術省

(IPHW区)

F. 最小投資しきい値の制限が50億ルピーの商品のリスト

S. No.	商品の説明
1.	半導体ウェーハ

G. 最小投資しきい値の制限が100億ルピーの商品のリスト

S. No.	商品の説明
1.	ロジックを含む半導体集積チップ (IC) [マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタルシグナルプロセッサ (DSP)、特定用途向け集積回路 (ASIC) など]; メモリ; アナログ/ミックスシグナルICなど
2.	電子アプリケーション用の液晶ディスプレイ (LCD)、発光ダイオード (LED)、有機発光ダイオード (OLED) などを含むディスプレイ製造ユニット

\*\*\*\*

インド政府  
電子情報技術省  
(IPHW区)

修正エレクトロニクス製造クラスター計画 (EMC 2.0)

1. 背景と目標 :

1.1. 国内のエレクトロニクス製品の製造拠点は、その製品の需要と比較してとても不十分である。インドで製造された場合も、国内の付加価値の程度が低い。投資を誘致するため、直面する主な制約は産業の成長と地域全体への分散を促進する信頼性や良質のインフラの入手不能である。産業化や国のエレクトロニクス製造の成長を促進することを考え、2012年10月に政府は電子システムデザインと製造 (ESDM) 部へ投資を誘い寄せるためにEMCに世界で第一のインフラを設置するように支援を求めている。2017年10月から、この計画が申請書の受領に対して閉鎖された。その計画の影響とESDMの成長にとってその計画の必要さについて分析するため、EMC計画が学際的影響評価委員会に値踏みされ、独立機関にサードパーティ分析された。この産業とEMCで製造業務をセットアップしたいといった利害関係者の激励の応答を踏まえ、この計画がエレクトロニクス製造を容易にするため役だったと考えられている。そのうえ、このような計画を修正して続ける必要があると勧められ、それによ

インド政府  
電子情報技術省  
(IPHW区)

ってグローバルと国内の両方の投資家の誘致ができ、EMC内での生産を開始もできる。それで、エレクトロニクス製造部門でグローバルバリューチェーンとの統合を確保できる。したがって、政府の取り組み「Digital India」および「Make in India」イニシアチブで想定されているようにインドをエレクトロニクス製造の中心にするため、電子情報技術省は修正エレクトロニクス製造クラスター計画（EMC 2.0）の導入を提案している。

1.2. このEMCは、EDSMの成長を容易にし、起業家の生態系の開発の役に立ち、イノベーションを推進し、投資を引き付けて地域の経済成長を促進し、雇用機会や税収を増加させる。

## 2. 修正エレクトロニクス製造クラスター計画（EMC 2.0）

2.1. 修正エレクトロニクス製造クラスター計画（EMC 2.0）によると、エレクトロニクス製造部への投資を誘致するため、工業団地/公園などのインフラをアップグレードし、EMCプロジェクトで共有設備を備え付けるインフラの共有設備センター（CFC）を作るエレクトロニクス製造クラスターが設立された。スキームは、プロジェクト実施機関が作成する実現可能性調査報告書を通じて認め、必要に基づいて識別されるコンポーネントを含む。

インド政府  
電子情報技術省  
(IPHW区)

2.2 経済的支援は、エレクトロニクス製造クラスター (EMC)

と共有設備センター (CFC) のセットアップのためになる。

2.2.1. EMC プロジェクトは基礎的なインフラと快適装備と他の共同施設の開発を重点に置く未発達／低開発の地理的地域、できれば隣接である。

2.2.2 共通施設センター (CFC):地域にかなりの数の既存しているESDMユニットが位置するべきである。そして共同技術インフラを整備したり、既存のEMCsと工業地域／団地にあるESDMユニットに共同施設を与えたりすることに重点を置く。

2.2.3. アンカーユニットはEMCに電子装置製造施設を設置するため、提案されているEMCのプロジェクトに売却できる／賃貸できる面積の最低限20%を購入の確約する電子装置製造会社であり、30億や以上の投資を確約する

2.2.4. プロジェクト管理機関 (PMA)はインド政府の電子情報技術省 (MeitY)の下で自律体 (社会及びPSU) の形態の機関である。このような機関はプロジェクト管理機関として働き、秘書、管理、実施支援を提供する責任があり、時々電子情報技術省に任される責任を

インド政府  
電子情報技術省  
(IPHW区)

行う。PMAの機能と責任は別にMeitYに発行されるスキームの指針に述べられる。

**2.2.5. プロジェクト実施機関 (PIA)**はPMAにプロジェクトの申し込みを提出する機関である。スキームの下での申し込みは州政府やSIA (州実施機関)や国家公共部門ユニット(CPSU) や州公共部門ユニット (SPSU)や産業回廊開発公社 (ICDC)例えばDMICDC など (場合によって) が作り出すことができる。PMAに申し込みを提出する機関はPIAと呼ばれる。

**2.2.6. プロジェクトレビュー委員会 (PRC):**スキームの下に承認合意のために申し込みを検討するのに、共同秘書の以下の地位のない役人のチェアマンシップの下で電子情報技術省に構成されている委員会である。PRCは他の省庁／部署／団体の代表者を含める。PRCはEMC2.0スキームによって申し込みの承認や拒否についてPMAに推薦する。PMCは承認されたプロジェクトの進展も確認する。PMCの会議が時々と必要な時に開催される。詳細な構成、PRCの機能と責任はスキームの指針に述べられる。

**2.2.7. 理事会 (GC):** 秘書のチェアマンシップの下で電子情報技術省に構成されている委員会である。GCは政府と工業の専門家を含め

インド政府  
電子情報技術省  
(IPHW区)

る。GC はスキームとプロジェクトの進展を定期的に確認する。GC はスキームの成功実施のため時々スキームの指針の改善／修正（必要なら）する機関である。GCの機能と責任はスキームの指針に述べられる。

2.3 申し込み方法と資格：EMC 2.0スキームに基づく申し込みは州政府や州実施機関 (SIA) や CPSU や SPSU や産業回廊開発公社(ICDC) 例えば DMICDCなど (場合によって)がPIA及び関連するanchor unit の役割と責任を明確に述べられるアンカーユニットの詳細をPMAに提出する。CPSU やSPSUの場合申し込みは関連の中央政府や州政府（行政省や省庁）の推薦と共に提出する。

EMC2.0 スキームに基づく申し込みは以下に従うべきである：

- i. EMCプロジェクトのため、アンカーユニットや工業から購入できる／賃貸できる土地面積を少なくとも20%を取得（購入／賃貸）することを確約するべきで、最低限30億の投資を確約しなければならない。
- ii. 土地区画は200エーカー以下であってはならない

インド政府  
電子情報技術省  
(IPHW区)

- iii. 東州と兵陸州と連邦直轄領に必要される土地区画は100エーカー以下であってはならない。その地域では最低限の投資確約は15憶である。
- iv. 提案される土地区画はPIAに所有され、できれば隣接しているのがいいである。
- v. ½キロメートルの半径以内に最大二つの土地区画は隣接していると見なされる。道路の向いにある土地区画は隣接していると見なされる
- vi. 際に、EMCスキームに基づく存在しているクラスターは拡張のために取得し、EMC 2.0スキームの下に隣接地の発展が提案され、存在している製造ユニットがある地域も土地区画の部分見なされる。これは存在しているEMCに購入できる／賃貸できる地域の80%は製造ユニットに割り当てるべきで少なくとも割り当てられる地域の50%のユニットは生産活動を始めるべきだった。そのような場合、土地要件にかんれんする以下の条件が適用される：
  - a) 既存のEMCに隣接している少なくとも100エーカーの土地区画がスキームの下に申し込むための最低限の土地要件が満たされていると見なされる。
  - b) 東州と兵陸州と連邦直轄領は既存のemcに隣接している少なくとも50%のその土地区画はスキームの下に申し込むための最低限の土地要件が満たされていると見なされる。こ

インド政府  
電子情報技術省  
(IPHW区)

ういう場合は、EMC 2.0 スキームの下に提案された新しい地域は金融支援の資格があるとみなされる。

こういう場合は、EMC 2.0 スキームの下に提案された新しい地域は金融支援の資格があるとみなされる。

- vii. 提案される土地区画は妨害されないべきで産業利用されるべきである。
- viii. 共通施設センター (CFC)のため少なくとも5つの電子製品製造ユニットが施設のユーザーとして認定されるのが必要である。
- ix. PIA はEMC以内の少なくとも10%の購入できる／賃貸できる地域に既製工場 (RBF)小屋／プラグン・プレイ施設を提供する。

3. **資金援助:** 国際的レベルのインフラと共に共同の施設と快適装備を創出するために金融援助が与えられる。金融支援は以下の通り、電子製品製造クラスター(EMCs)と共同施設センターに与えられる。

- 3.1. EMCプロジェクトのため：資金援助は100エーカーの土地ごとに7億の上限対象であり、プロジェクト費用の50%に限られる。より広い地域のため比例上限が適用されますが一つのプロジェクトに

インド政府  
電子情報技術省  
(IPHW区)

つき、35億を超えない。残りのプロジェクト費用と共にプロジェクト費用の50%最小貢献度は州政府や州政府や州実施機関(SIA)や国家公共部門ユニット(CPSU)や州公共部門ユニット(PSU)や産業回廊開発公社(ICDC)例えばDMICDCなど(場合によって)が負担する。

3.2 共通施設センターのため(CFCs); 7億5百万の上限対象であり、プロジェクト費用の75%に限られる。残りのプロジェクト費用と共にプロジェクト費用の25%の最小貢献度は州政府や州実施機関(SIA)や国家公共部門ユニット(CPSU)や州公共部門ユニット(PSU)や産業回廊開発公社(ICDC)例えばDMICDCなど(場合によって)が負担する。

4. EMC 2.0政策に基づく財政支援のすべての提案は、電子情報技術省(MeitY)によって構成されるプロジェクト審査委員会(PRC)によって検討される。PRCは他の省庁/部門および組織の代表者で構成され、議長としてMeitYの共同書記のランクを下回らない役員が務める。PRCは、EMC 2.0スキームに基づく申請の承認/拒否についてPMAに推奨を行う。PRCはまたは承認された申請

インド政府  
電子情報技術省  
(IPHW区)

の進捗状況を確認する。PRCの詳細な構成、機能、および責任については、スキームガイドラインで詳しく説明する。

5. EMC 2.0政策に基づく適格な活動の例示的なリストが添付されている。

6. EMCに関するプロジェクトの準備、評価、および資金の放出：

6.1 PIAからPMAに提出されたプロジェクトの申請には、EMCの特定のプロジェクトのインフラの要件と共通施設の詳細が含まれている。プロジェクトの提案には、データ、調査、予測、およびEMCの成長の可能性に関する実現可能性も含まれる。PIAは、必要に応じて、アンカーユニット、R&D機関、金融機関、州政府などのような機関からのサポートを積極的に関与させることができる。

6.2 PMAは、[必要に応じて]専門のコンサルティング会社または金融機関の支援を得て申請を評価する。PMAは、プロジェクトの評価を指摘するレポートを提出してプロジェクト審査委員会の検討をもらう。PRCは、プロジェクトの承認/却下についてPMAに勧告をする。

インド政府  
電子情報技術省  
(IPHW区)

6.3 PRCの推薦に基づいて、PMAはプロジェクトの承認の発行をするため財務権限規則の委任 (DFPR)に従う所轄官庁から必要な承認を得る。PMAの機能と責任はスキームの指針に述べられる。

6.4 EMCの選択/位置はPIAがアンカーユニット/工場と相談して取り上げられる。

7. 資金の放出：資金の放出はプロジェクトにより、パリーパスで、以下の方法のように三回の割賦に放出されることが提案されている。

7.1. 第1回分はプロジェクトが承認した後払い金として放出する

7.2. 第2回分は第1回分が全部利用され、インフラの発展とアンカーユニットに土地の割り当てに関する特定なマイルストーンが達成した後、放出される。

7.3. 第3回分はプロジェクトが完了した後放出される。

7.4. 資金はPMAを通じて、PIAが指定口座にパリーパス拠出金を入金した時や関連の州政府や省庁/部(場合によって)パリーパス拠出金の移動のために制裁や指令を出した時、PIAに放出する。PIAの内部発

インド政府  
電子情報技術省  
(IPHW区)

生や金融機関の銀行からの金融支援の場合、指定口座に資金が振り込まれるべきである。

## 8. 実装メカニズム

**8.1** スキームは、自治体(社会や公共事業) としてインド政府のエレクトロニクスと情報技術省 (MeitY) の下、政府機関の形で実施されます。そのような機関は、プロジェクト管理機関 (PMA) として秘書、管理および実装のサポートを提供する他 MeitYによって随時割り当てられる責任も働きます。PMAの機能と責任は、MeitYが発行されたスキームガイドラインで詳しく説明されます。

**8.2** MeitYは、スキームで承認されたプロジェクトの予算規定を提供します。PMAはプロジェクトごとの要件の詳細とともに予算要件を定期的にMeitYに提出します。承認されたプロジェクトのためにPMAからPIAに財政援助を与えられます。

9. スキーム/プロジェクトの監視：スキームの進捗状況を、書記長のもとで、MeitYによって構成された統治評議会 (GC) で見直されます。GCは政府と業界の専門家で構成されます。GCは、

インド政府  
電子情報技術省  
(IPHW区)

スキームとプロジェクトの進捗状況を定期的に確認します。スキームの実装を成功させるために時々GCはスキームガイドラインの修正を実施する権限を与えられます。GCの詳細な構成、機能、および責任については、スキームガイドラインで詳しく説明します。

10. **スキーム期間/タイムライン**：このスキームは、通知日から3年間で、申請を受け付けます。承認されたプロジェクトへの資金の支払いには、さらに5年間の期間を設ける必要があります。スキームに基づいて受け取ったアプリケーションは、継続的に評価されます。
11. **MeitY**は、このスキームを実施するための一連のガイドラインを発行します。スキームのガイドラインの改正権限はMeitYによって設立されるスキームの統治評議会に委ねられます。
12. **MeitY**は、スキームとEMC 2.0スキームに基づくプロジェクトの進捗状況を定期的に監視および確認します。

インド政府  
電子情報技術省  
(IPHW区)

13. MeitYは、通知日から3年後にスキームの中間評価を行い、変更/修正があれば提案します。スキームの実装を成功させるために必要です。スキーム期間の終了後、このような中間評価と別の評価を実施するために、独立機関のサービスを利用します。

インド政府  
電子情報技術省  
(IPHW区)

EMC 2.0 スキームへの付加

EMC 2.0 スキームに基づく資格活動の実例的リスト

1 重要なサービス

- i. 境界壁
- ii. 内部道路
- iii. 雨水排水管
- iv. 電気サブステーション／配電ネットワーク

B. 不可欠なサービス

- I. 廃棄物処理／再生利用
- II. 循環水／水処理工場
- III. 排水処理工場
- IV. 下水道
- V. 電子廃棄物管理
- VI. 街路照明
- VII. 非常用電源工場
- VIII. 倉庫保管
- IX. 建売工場小屋／プラグン・プレイ施設
- X. 消火活動と安全サービス

C. 望まれるサービス

1. 福祉サービス

- I. 従業員ホステル
- II. 病院と従業員国家保険公社

インド政府  
電子情報技術省  
(IPHW区)

- III. 娯楽施設と遊び場
- IV. 保育園
- V. 教育施設
- VI. 銀行および金融サービス

**2. サポートサービス**

- i) 卓越した研究拠点（研究開発、起業支援およびコンサルティングサービス）
- ii) 能力開発センター/トレーニング施設
- iii) 講堂と会議施設
- iv) ビデオ会議、ITおよび通信インフラ
- v) ビジネス、貿易、コンベンションセンター

**3. 製造サポート**

- I. 工具室
- II. コンピューターを使った設計システム(CAD)、コンピューター支援製造(CAM)を使っているデザインハウス
- III. プラスチックの成形/キャビネットの製造
- IV. 板金プレス
- V. 包装/エポキシサプライヤー
- VI. 試験施設および認証施設
- VII. 成分試験:
  - a) 安全性、寿命試験、信頼性/環境、電気的および機械的特性
  - b) RoHS試験
  - c) EMI / EMC試験
  - d) CROコンプライアンス

\*\*\*\*\*

インド政府  
電子情報技術省  
(IPHW区)